

* 本資料は、韓国・ソウル、日本・東京(現地時間2012年2月24日)にて発表された内容の抄訳です。

2012年2月27日

フェリカネットワークス株式会社

サムスン電子、フェリカネットワークス株式会社と モバイルNFCソリューションで提携

(ソウル、東京 2012年2月24日) - 先進的な半導体ソリューションで世界をリードするサムスン電子株式会社(以下サムスン電子)と近距離無線通信技術 Near Field Communication(以下 NFC) サービスプラットフォームとそのソリューションを提供し続け業界の先を行くフェリカネットワークス株式会社(以下フェリカネットワークス)は、本日、日本における NFC 対応モバイルサービスの本格展開を視野に、提携を発表しました。サムスン電子はフェリカネットワークスの戦略的パートナーとして、信頼性と効率性両面を兼ね備えたモバイル端末のおサイフケータイ®機能を実現する NFC 互換の FeliCa™ IC ソリューションの開発にあたります。サムスン/フェリカネットワークスの NFC-SAM(セキュア アプリケーション モジュール) チップを搭載することで、電子マネー、クレジットカード、交通乗車券をはじめ、ユーザーが安全に使える幅広い機能を携帯電話の中に取り込めます。

サムスン電子 デバイス・ソリューション、システム LSI セールス/マーケティングバイス・プレジデントの Taehoon Kim は、「サムスンの卓越した RF 技術とデータ暗号化技術を生かし、フェリカネットワークスとともに NFC-SAM IC ソリューション開発に取り組めることを嬉しく思います」とした上で、「フェリカネットワークスの卓越した FeliCa プラットフォームの運営能力と、半導体設計とプロセス分野でのサムスンの世界屈指の技術力をひとつにするこの取り組みは、モバイル決済市場に、更に大きな価値を生み出すものです」と続けています。

フェリカネットワークス社長の杉山博高は、「フェリカネットワークスが2004年以来積み上げてきたモバイル非接触技術及びプラットフォーム運営面での経験と専門性を基盤に、新たな NFC-SAM IC ソリューションの開発に向けて半導体業界のリーダーであるサムスンと協働することに大きな喜びを感じます」と述べ、「両社の技術の融合は、世界におけるモバイル NFC 事業の更なる発展を後押しするものです。世界のお客様に快適性をもたらす NFC-SAM IC チップの開発と同時に、今後様々な NFC ソリューションを提供していく予定です」としています。

提携を通し、サムスンは、国際規格 ISO/IEC 14443/18092 (タイプ A/B 及び FeliCa™) 準拠の NFC コントローラーに加え、先端セキュリティー機能を備えた FeliCa™ SAM IC チップの開発に携わります。フェリカネットワークスは、サムスンに対し、主要技術の提供を行います。フェリカネットワークスからの技術提供により、日本で既に確立している FeliCa™ (NFC-F)リーダとおサイフケータイ®を利用した世界最大のモバイル非接触インフラでの相互運用が可能となります。両社が貢献することで、優れた NFC-SAM チップの開発につながるだけでなく、既存のおサイフケータイ®のインフラやサービスがそのまま利用可能になります。また、世界各国で、NFC コントローラーを NFC リーダやサービスに搭載することも可能となります。

新開発の NFC-SAM チップの商品化は、2013 年を目標としています。

フェリカネットワークス株式会社 <http://www.FeliCaNetworks.co.jp/>

サムスン電子株式会社 <http://www.samsung.com/jp/>

- * Samsungは、Samsung Electronics Co., Ltd.の登録商標です。
- * FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカード技術です。
- * FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- * おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。